This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

METHOD FOR ASSEMBLING LIQUID CRYSTAL SUBSTRATE

Patent Number:

JP2001042341

Publication date:

2001-02-16

Inventor(s):

SAITO MASAYUKI;; HACHIMAN SATOSHI;; IMAIZUMI KIYOSHI;; KAWASUMI

YUKIHIRO;; HIRAI AKIRA

Applicant(s):

HITACHI TECHNO ENG CO LTD

Requested

Patent:

☐ JP2001042341

Application

Number:

JP19990220160 19990803

Priority Number

(s):

IPC Classification: G02F1/1339; G02F1/13; G02F1/1341

EC Classification: Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance sticking productivity by bringing a liquid crystal agent supplied onto one substrate into contact with the other substrate held on a rear surface of a pressing plate, moving either substrate, spreading the liquid crystal agent on the main surface of the substrate and sticking the substrates to each other.

SOLUTION: A liquid crystal agent P is applied on plural locations on a lower substrate 1a and the liquid crystal agent on one location at this point of time is defined as P1. Then, after an upper substrate 1b descends and its rear surface just comes in contact with the liquid crystal agent P, the liquid crystal agent P2 is squashed and spread when the rear surface further descends. The lower substrate is moved form the original location at which the upper substrate just comes into contact with the liquid crystal agent P1 in an X axis + direction, in the X axis - direction and returned to the original location and moved in the Y axis + direction and then in the Y axis - direction in a state that the upper substrate 1b is in contact with the liquid crystal agent P1. The liquid crystal agent is spread so as to form a generally rectangular shape having a diameter having a length equal to a required movement distance as shown by P4-P6 by the movement of the lower substrate 1a in each X and Y axis direction to the upper substrate 1b. In such a way, the liquid crystal agent reaches every part inside of a patter of a sealing agent thoroughly and then sticking of the lower substrate 1a and the upper substrate 1b is executed.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

G02F 1/1339

(51) Int.Cl.7

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-42341

(P2001-42341A)

テーマコート*(参考)

2H088

最終頁に続く

(43)公開日 平成13年2月16日(2001.2.16)

505

	1/13 1/1341	101	1/13 1/1341		101 2H089		
			審査請求	未請求	請求項の数4	OL	(全7頁)
(21) 出願番号	<u> </u>	特願平 11-220160	(71) 出願人	000233077 日立テクノエンジニアリング株式会社			
(22)出顧日		平成11年8月3日(1999.8.3)	(72) 発明者	齊藤 正 茨城県	足立区中川四丁 E行 竜ヶ崎市向陽台 ンジニアリング	5丁目	2番 日立テ
			(72)発明者	茨城県	窓 竜ヶ崎市向陽台 ンジニアリング		
		•	(74)代理人	1000592	269		

FΙ

G 0 2 F 1/1339

(54) 【発明の名称】 液晶基板の組立方法

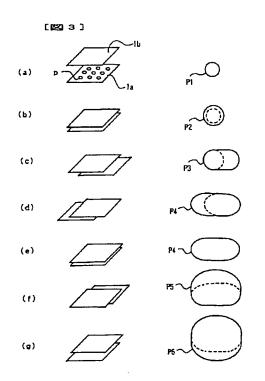
(57)【要約】

【課題】液晶剤の供給量を正確にする一方で、液晶剤の 広がり時間を短くして液晶基板を短時間で貼り合わせ、 生産性を向上することができる液晶基板の組立方法を提 供することである。

識別記号

505

【解決手段】貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、テーブル上に保持した基板上に液晶剤を供給した後、両基板の間隔を狭めていづれかの基板に設けた接着剤により両基板を貼り合わせる液晶基板の組立方法であり、テーブル上に保持した他方の基板上に供給した液晶剤と加圧板の下面に保持した基板を接触させ、いづれかの基板を移動させることにより液晶剤を基板の主面の広がり方向に拡張させ、その後に基板の貼り合せを行なう。



弁理士 秋本 正実

【特許請求の範囲】

【請求項1】貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、テーブル上に保持した基板上に液晶剤を供給した後、両基板の間隔を狭めていづれかの基板に設けた接着剤により両基板を貼り合わせる液晶基板の組立方法において、

テーブル上に保持した他方の基板上に供給した液晶剤と加圧板の下面に保持した基板を接触させ、その状態でいづれかの基板を移動させることにより液晶剤を基板の主面の広がり方向に拡張させ、その後に基板の貼り合せを行なうことを特徴とする液晶基板の組立方法。

【請求項2】上記請求項1に記載の液晶基板の組立方法 において、

移動させるいづれかの基板の移動方向は基板の主面の広がり方向であることを特徴とする液晶基板の組立方法。

【請求項3】上記請求項1に記載の液晶基板の組立方法 において、

いづれかの基板に設けた接着剤に片方の基板が接触しない状態で、テーブル上に保持した他方の基板上に供給した液晶剤と加圧板の下面に保持した基板が接触するようにして、液晶剤を基板の主面の広がり方向に拡張させることを特徴とする液晶基板の組立方法。

【請求項4】上記請求項1に記載の液晶基板の組立方法 において、

接着剤をクローズしたパターンを持つようにいづれかの 基板に設け、そのパターン内になるように接着剤よりも 厚く液晶剤を供給し、真空チャンバ内で両基板の間隔を 狭めて該接着剤により両基板を貼り合わせることを特徴 とする液晶基板の組立方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、貼り合せる基板同士をそれぞれ保持して対向させ、間隔を狭めて貼り合わせる液晶基板の組立方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示パネルの製造には、透明電極や 薄膜トランジスタアレイを付けた2枚のガラス基板を数 μm程度の極めて接近した間隔をもって接着剤(以下、 シール剤ともいう)で貼り合わせ、それによって形成さ れる空間に液晶剤を封止する工程がある。

【0003】この液晶剤の封止には、一方の基板上に注入口を設けないようにシール剤をクローズしたパターンに描画し、さらに、そのパターン内になるように液晶剤を滴下しておいて他方の基板を一方の基板上に配置し、真空中で上下の基板を接近させて貼り合せる特開昭62~165622号公報などで提案された方法がある。【0004】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、シ ール剤のクローズしたパターンの中に供給される液晶剤 が本来必要な塗布量よりも多くなって貼り合せ後に液晶 剤がシール剤の外側にあふれ出ることがある。この場 合、基板の洗浄が必要であり、また高価な液晶剤を無駄 にしてしまう。

【0005】必要な量だけを正確に供給する方法として、プランジャーによるものが一般的であるが、一滴ずつ打点として塗布するため、貼り合せた後、パターンの内側に液晶剤が広がりきるまでに、数分から数十分の時間を要してしまう。

【0006】一滴の量を少ないものとし液晶剤の広がり 領域を狭めて液晶の広がり時間を短縮しようとすれば、 打点数を増して全体として必要な供給量を維持すること が必要で、この場合には、1回の打点での塗布量が少な いので、塗布量がばらつきやすくなり、また、打点数が 増えた分、液晶剤の供給に時間がかかってしまう。

【0007】即ち、液晶の供給量を正確にして洗浄工程を省き、かつ液晶の無駄な供給をしないようにすることと、供給後における液晶の広がり時間を狭めて貼り合わせ時間を短縮し生産性を向上させることは、同時に達成できない状況にあった。

【0008】それゆえ、本発明の目的は、液晶剤の供給量を正確にする一方で液晶剤の広がり時間を短くして、液晶基板を短時間で貼り合わせ生産性を向上することができる液晶基板の組立方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明の特徴とするところは、貼り合わせる一方の基板を加 圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブ ル上に保持して対向させ、テーブル上に保持した基板上 に液晶剤を供給した後、両基板の間隔を狭めていづれか の基板に設けた接着剤により両基板を貼り合わせる液晶 基板の組立方法において、テーブル上に保持した他方の 基板上に供給した液晶剤と加圧板の下面に保持した基板 を接触させ、この状態でいづれかの基板を移動させるこ とにより液晶剤を基板の主面の広がり方向に拡張させ、 その後に基板の貼り合せを行なうことにある。さらに、 いづれかの基板に設けた接着剤に片方の基板が接触しな い状態で、テーブル上に保持した他方の基板上に供給し た液晶剤と加圧板の下面に保持した基板が接触するよう にして、液晶剤を基板の主面の広がり方向に拡張させる ことにある。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図に 基づいて説明する。

【0011】図1において、本発明方法を具現化する基板組立装置は、液晶滴下部S1と基板貼合部S2から構成され、この両部分は架台2上に隣接して配置される。【0012】架台2の上方には基板貼合部S2を支持するフレーム3がある。また、架台2の上面には、 $XY\theta$ ステージT1が備えられている。 $XY\theta$ ステージT1を

構成するXステージ4aは、駆動モータ5により、図面 上で左右のX軸方向に、即ち、液晶滴下部S1と基板貼 合部S2間を往来できるようになっている。Yステージ 4 bはXステージ4 a上にあり、駆動モータ6によりX ステージと直交するY軸方向に往来できるようになって いる。 θ ステージ4cはYステージ4b上にあり、回転 ベアリング7を介して駆動モータ8によりYステージ4 bに対して水平に回転可能になっていて、 θ ステージ4 c上に下基板1aを搭載するテーブル9が固定される。 なお、後述する上基板と同様に、テーブル9は真空吸着 や静電吸着で下基板1aを搭載保持をする。また、Yス テージ4 bにプレート13で下チャンバユニット10が 固定されている。 θステージ4 c は、下チャンバユニッ ト10に対し回転ベアリング11と真空シール12を介 して回転自由に取付けられ、θステージ4cが回転して も下チャンバユニット10はつられて回転しない構造と している。

【0013】液晶滴下部S1は、テーブル9に搭載保持された下基板1aに所望量の液晶剤を滴下するためのフレーム3から突出したブラケット14で支持されたディスペンサ17とこれを上下移動させるためのZ軸ステージ15とそれを駆動するモータ16で構成される。下基板1aをデーブル9上に保持搭載した $XY\theta$ ステージT1は、液晶剤を滴下するディスペンサ17のノズル18に対し、XおよびY方向に移動する。これにより、下基板1a上の任意の個所に所望量の液晶剤が滴下される。【0014】液晶滴下後の下基板1aを搭載保持した $XY\theta$ ステージT1は、基板貼合部S2の下部に駆動モータ5によって移動する。

【0015】基板貼合部S2では、上チャンバユニット21とその内部の真空吸着機能と静電吸着機能を備えた加圧板27がそれぞれ独立して上下動できる構造になっている。即ち、上チャンバユニット21は、リニアブッシュと真空シールを内蔵したハウジング30を有しており、シャフト29をガイドとしてフレーム3に固定されたシリンダ22により上下のZ軸方向に移動する。

【0016】XY のステージT 1が基板貼合部S 2に移動していて上チャンバユニット 2 1が下降すると、下チャンバユニット 1 0の周りに配置してある0リング44に上チャンバユニット 2 1のフランジ 2 1 aが接触し一体となり、この時真空チャンバとして機能する状態になる。ここで、下チャンバユニット 1 0の周囲に設置されたボールベアリング87は、真空による0リング44のつぶれ量を調整するもので上下方向の任意の位置に設定可能となっている。真空化により発生する大きな力は、ボールベアリング87を介して下チャンバユニット 1 0で受けており、0リング44の弾性変形が可能で、後述するように貼り合わせ時に XY のステージT 1を0リング44の弾性範囲内で容易に微動させ精密位置決することができる。

【0017】ハウジング30は、上チャンバユニット21が下チャンバユニット10と真空チャンバを形成して変形しても、シャフト29に対し真空漏れを起こさないで上下動可能な真空シールを内蔵しているので、真空チャンバの変形がシャフト29に固定された加圧板27が変形することを防止でき、後述するように加圧板27に保持された上基板1bとテーブル9に保持された下基板1aとの平行を保って貼り合せが可能となる。

【0018】23は真空バルブ、24は配管ホースで、図示していない真空源に接続され、これらは真空チャンバを減圧し真空にする時に使用される。また、25はガスパージバルブ、26はガスチューブで、N2やクリーンドライエアー等の圧力源に接続され、これらは真空チャンバを大気圧に戻す時に使用される。

【0019】上基板1 bは加圧板27の下面に密着保持されるが、大気下においては真空吸着(あるいは吸引吸着)で保持されるようになっている。即ち、41は吸引吸着用継手、42は吸引チューブであり、図示していない真空源に接続され、加圧板27面には、それにつながる複数の吸引孔が設けられている。

【0020】次に、静電吸着手段について説明する。

【0021】加圧板27は下面に方形の凹部を2個有していて、各凹部に内蔵された平板電極を誘電体で覆ってその誘電体の主面が加圧板27の下面と同一平面になっている。埋め込まれた各平板電極はそれぞれ正負の直流電源に適宜なスイッチを介して接続されている。従って、各平板電極に正あるいは負の電圧が印加されると、加圧板27の下面と同一平面になっている誘電体の主面に負あるいは正の電荷が誘起され、それら電荷によって上基板1bが静電吸着される。各平板電極に印加する電圧は同極でもよいしそれぞれ異なる双極でもよい。尚、周りが大気の場合、真空吸着手段を不要としてもよい場合は、真空吸着手段を不要としてもよい。

【0022】さて、シャフト29はハウジング31、32に固定されている。ハウジング31はフレーム3に対してリニアガイド34で取付けられ、加圧板27は上下動可能な構造になっている。その上下駆動は、フレーム3とつながるフレーム35上のブラケット38に固定されたモータ40により行う。駆動の伝達は、ボールねじ36とナットハウジング37で実行される。ナットハウジング37は荷重計33を介してハウジング32とつながり、その下部の加圧板27と一体で動作する。

【0023】従って、モータ40によってシャフト29が下降し、上基板1bを保持した加圧板27が下降し、上基板1bがテーブル9上の下基板1aと密着して、貼り合わせに必要な加圧力を与えることのできる構造となっている。この場合、荷重計33は加圧力センサとして

働き、逐次、フィードバックされた信号を基にモータ40を制御することで、上下基板1a,1bに所望の加圧力を与えることが可能となっている。

【0024】下基板1aは重力方向の搭載なので、図2 に示すようにテーブル9に設けた位置決め部材81に押付ローラ82による水平方向での押付けによる位置決めの固定で十分である。

【0025】しかしながら、貼り合わす直前の微小位置 決めの際、上基板1 bが下基板1 a上のシール剤や液晶 剤と接触した影響で下基板1 aがずれたり持上がる可能 性があることや、真空チャンバ内が減圧され真空になる 過程で下基板1 aとテーブル9との間に入り込んでいる 空気が逃げて下基板1 aが踊りずれる可能性があるので、テーブル9に対しても静電吸着の機能を持たせている。そして、テーブル9に上下2軸方向に移動できるピンを設け接地しておくと、貼り合わせ後の基板の帯電防止とテーブル9からの取り外しを容易に行なうことができる。

【0026】図2に示す60は、加圧板27が真空吸着をしていて真空チャンバが減圧され真空吸着力が消えて上基板1bが落下するときに加圧板27の僅か下の位置で受け止める受止爪で、上基板1bの2個の対角の位置にあって下方に伸びたシャフト59で釣り下げた形に支持されている。具体的には図示していないが、シャフト59は上チャンバユニット21介して真空シールされて回転と上下移動ができるようになっている。また、シャフト59は、加圧板27の上下移動と独立して上下に移動できるだけでなく、回転アクチェータによって回転させて、受止爪60が液晶を両基板1a、1bの主面の広がり方向に拡張させたり、その後に基板の貼り合せを行なう場合の邪魔にならぬように退避させることができるようになっている。

【0027】次に、本基板組立装置で基板を貼り合わせる工程について説明する。

【0028】先ず、テーブル9に上基板1 bを保持した 治具を搭載し、駆動モータ5で $XY\theta$ ステージT1 を基 板貼合部S2に移動させる。そこでモータ40によりシャフト29を介して加圧板27を下降させ、テーブル9 上の上基板1 bを真空吸着させてから、モータ40で上 昇させて、上基板1 bを特機状態とする。

【0029】 $XY\theta$ ステージT1は液晶滴下部S1に戻り、空になった治具が外され、テーブル9上に下基板1aが搭載され、図2に示すように所望位置に固定保持される

【0030】図1には示していないが、液晶剤を吐出滴下するデイスペンサ17の近くのフレーム3にシール剤を吐出するデイスペンサがあって、XY θ ステージT1の各モータ5、6で下基板1aをXY軸方向に移動させつつシール剤を吐出させて、下基板1a上にクローズ(閉鎖)したパターンでシール剤を描画する。

【0031】その後、デイスペンサ17から液晶剤を下基板1a上に滴下する。

【0032】続いて、 $XY\theta$ ステージT1を基板貼合部 S2に移動させ、加圧板27に保持している上基板1 b の下面が下基板1 a上の液晶剤に接触する高さまで下降 させる。

【0033】液晶剤は表面張力により数mm程度の高さに盛り上がっており、それに対して、シール剤の高さは20μm程度になっている。よって、上基板1bはシール剤に触れない高さで、十分に液晶剤に接触する。

【0034】以下、図3に示したモデルで液晶剤を下基板1aの主面の広がり方向に拡張させる工程について説明する。

【0035】図3の左側の図は両基板1a,1bの位置 関係を示し、右側の図は下基板1a上の1箇所の液晶剤 Pの広がり状況を平面的に表すもので、実線が現状での 広がりを、また点線がその1工程前での広がり状況を示 している。

【0036】図3(a)の左側では、下基板1a上に複数箇所に液晶剤Pを塗布供給した状況を示している。この時点での1箇所の液晶剤をP1とする。

【0037】上基板1bを下降させその下面が液晶剤Pに接触した後、さらに上基板1bを下降させると、図3(b)の右側のように液晶剤はP2のように押しつぶされて広がる(拡張する)。

【0038】上基板1 bが液晶剤に接触した状態のままで、XY θ ステージT 1 を最初の接触位置を中心として、図3 (c) 乃至図3 (g) に示すようにX軸+方向、X軸一方向、最初の接触位置、Y軸+方向、Y軸-方向にそれぞれ移動させる。

【0039】その移動の際、例えば、 $XY\theta$ ステージT 1がX軸+方向に移動する場合、液晶剤は上基板1bと の粘着でP3で示すようにがX軸+方向に広がる。

【0040】図3(d)以降のように、下基板1aがX Y O ステージT 1 で上基板 1 b に対し X Y 各軸方向に移 動することで液晶剤はP4からP6で示すように、XY θステージT1の移動距離の直径を持ったほぼ四角形の 形状に広がる。液晶剤を広げると厚さは薄くなって行く から、加圧板27は徐々に下降させていくが、上基板1 bの下面は下基板1aに設けているシール剤に接触しな いようにしている。すなわち、シール剤の塗布高さ、液 晶剤の塗布高さ、上下各基板1a,1bの対向面間距離 は装置が予じめ入力してあるデータで分っており、か つ、上下各基板は真空吸着されて平行になっているの で、モータ40で加圧板27を上基板1bの下面がシー ル剤に接触しない位置まで下降させ、次いで上下基板を XY各方向に相対移動させている間は、シール剤の形を くずさないよう(接触しないように)加圧板の移動距離 の管理を行なう。

【0041】かくして、液晶をシール剤のパターンの内

側に十分に行き渡らせた後、基板の貼り合せを行う。 【0042】即ち、シリンダ22で上チャンバユニット 21を下降させ、そのフランジ部21aをOリング44 に当接させて下チャンバユニット10と真空チャンバを 形成させる。そして、真空バルブ23を開放して真空チャンバ内を減圧していく。この時、上基板1bは加圧板 27に真空吸着された状態になっているので、減圧が進 み真空化していくと上基板1bに作用していた真空吸着 力は消えて行き、上基板1bが自重で落下する。これを 図2に示すように受止爪60で受け止めて、加圧板27 の僅か下の位置に保持しておく。

【0043】真空チャンバ内が充分真空になった時点で、加圧板27の静電吸着手段に電圧を印加して受止爪60上の上基板1bを加圧板27にクーロン力で保持する。この場合、既に真空になっているので、加圧板27と上基板1bの間に空気が残るようなことは無いし、その空気が逃げるときに上基板1bが踊ることもない。

【0044】その後、図示を省略した昇降アクチェータでシャフト59を下降させ、次に、回転アクチェータでシャフト59を回転させ、受止爪60が上下両基板の貼り合わせの邪魔にならぬようにしてから、モータ40で加圧板27をさらに下降させ、上基板1bの下面を下基板1a上のシール剤に接触させ、荷重計33でシール剤に付加する加圧力を計測しつつモータ40を制御して上下両基板1a,1bを所望間隔に貼り合わせる。

【0045】この場合、上基板1bは加圧板27に密着していて中央部が垂れ下がっていることはないから、液晶剤中のスペーサに悪影響を与えたり、基板同士の位置合わせが不良になることはない。因みに、位置合わせは図示を省略した上チャンバユニット21に設けた覗き窓から画像認識カメラで上下各基板1a,1bに設けられている位置合わせマークを読み取って画像処理により位置を計測し、XYのステージT1の各ステージ4a乃至4cを微動させて、高精度な位置合わせを行なう。この微動において、Oリング44が極端に変形しないで真空が維持されるように、ボールベアリング87が上下チャンバユニット10,21の間隔を維持している。

【0046】貼り合わせが終了すると、真空バルブ23を締めてガスパージバルブ25を開き、真空チャンバ内にN2やクリーンドライエアーを供給し、大気圧に戻してからガスパージバルブ25を閉じて、シリンダ22で上チャンバユニット21を上昇させ、 $XY\theta$ ステージT1を液晶滴下部S1に戻して、テーブル9から貼り合せた基板を外し、次の貼り合わせに備える。テーブル9から外した後、基板は下流のUV光照射装置や加熱装置などでシール剤が硬化される。

【0047】以上の実施形態では、シール剤を吐出して 液晶を滴下した後直ちに貼り合せに移行することができ るので、基板が塵埃を受けづらく生産歩留まりを向上で きる。また、 $XY\theta$ ステージT1を上基板1bの真空チャンバ内への搬送に利用でき、装置の小型化が図られている。特に、 $XY\theta$ ステージT1の移動で基板を保持したまま液晶剤を広げるので1基板への供給点数を減らすことができて供給量のばらつきは小さくなり、しかも、液晶剤の拡張を貼り合せる基板同士で行うので、短時間で供給から貼り合わせに進むことができ、生産性は向上する。

【0048】また、液晶剤は正確な量を供給することができるため、液晶剤がシール剤パターンの外側にあふれて基板を汚染するおそれがなく、かつ、洗浄工程は不要となって液晶剤の無駄な消費を無くすことができる。 【0049】本発明は以上説明した実施形態に限らず、以下の様に実施しても良い。

【0050】(1) 下基板1bに塗布される液晶剤が 点状以外の形状、たとえば線状などであってもよい。こ の場合、線の伸延方向と垂直な方向に基板同士を相対的 に移動させるだけで、液晶剤を広げることができる。 【0051】(2) 液晶剤を拡張させる基板同士の相 対的移動方向は、液晶剤がシール剤のパターンを超えな い範囲であれば、円形や渦巻き型など、どのようなもの であってもよい。

【0052】(3) 上基板1bはロボットハンドから 直接加圧板27に吸引吸着させてよい。

[0053]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 液晶剤の供給量を正確にする一方で、液晶の広がり時間 を短くして液晶基板を短時間で貼り合わせ、生産性を向 上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法の一実施形態を具現化する基板組立 装置の概略図である。

【図2】上下の各基板を貼り合わせるときの状況を示す 斜視図である。

【図3】下基板に塗布した液晶剤を上基板により拡張させていく過程を示す図である。

【符号の説明】

- 1a 下基板
- 1 b 上基板
- 9 テーブル
- 10 下チャンバユニット
- 17 デイスペンサ
- 21 上チャンバユニット
- 23 真空バルブ
- 27 加圧板
- T1 $XY\theta \lambda \tau \mathcal{V}$
- S1 液晶滴下部
- S 2 基板貼合部

【図2】 [図1] [222] [1201] 【図3】 [E2]3] (b) (c) (6) (0)

(f)

フロントページの続き

(72)発明者 今泉 潔

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

(72)発明者 川隅 幸宏

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72) 発明者 平井 明

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所

内

Fターム(参考) 2H088 EA03 FA01 FA10 FA16 FA17

FA20 FA25 FA28 FA30 HA03

MA16 MA17 MA18

2H089 NA22 NA32 NA35 NA42 NA49 NA56 NA60 QA12 TA04